

(Micro-shear)

دکتر زهرا جابری انصاری^{*}، دکتر مریم معزی زاده^{**}، دکتر رویا امینیان^{**}، دکتر علیرضا صدر^{***}، دکتر شهاب جابری انصاری^{***}، پروفسور جانجی تاگامی^{****}، دکتر یاسوشی شیمادا^{*****}

چکیده

سابقه و هدف: امروزه تحقیقات دندانپزشکی در جهت دستیابی به مواد چسبنده‌ای می‌باشند که دارای مقاومت باند مناسب، سادگی مراحل کار و راحتی کاربرد باشند. در این راستا باندینگ‌های سلف اچ (Self - etch) به بازار معرفی شده‌اند. هدف از این بررسی تعیین میزان قدرت باند در دو نوع ماده سلف اچ جدید و مقایسه آنها با باند موفق قبلی از این نوع می‌باشد.

مواد و روشها: روش جمع‌آوری اطلاعات در این مطالعه تجربی مشاهده بود. دندان‌های نهفته مولر سوم انسان پس از کشیده شدن و خردکشی در لایه‌های $1/5$ میلی‌متری برش داده شدند. برش‌ها به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم گردیدند. در گروه اول باند Clearfil SE Bond (Kuraray - Japan) در گروه دوم باند Clearfil Protect Bond (Kuraray - Japan) (به عنوان کنترل) و در گروه سوم باند Clearfil Tri-S Bond (Kuraray - Japan) طبق دستورالعمل کارخانه استفاده شدند. روی هر برش، کامپوزیت Clearfil AP-X (Kuraray-Japan) در لوله‌هایی به قطر $7/50$ میلی‌متر و طول 1 میلی‌متر روی مینا و عاج قرار داده شدند. پس از کیبور کردن کامپوزیت و برداشتن لوله‌ها، نمونه‌های هر گروه به طور تصادفی به سه زیرگروه تقسیم گردیدند. کلیه گروه‌ها در ظرف‌های جداگانه در آب مقطر قرار داده شدند. استحکام ریزپرسی زیرگروه‌های اول هر سه گروه پس از 24 ساعت توسط دستگاه EZ-test (Shimadzu Co. Kyoto, Japan) اندازه‌گیری شد. یافته‌ها توسط آزمون ANOVA پک‌ظرفه و مقایسه چندتایی LSD با فاصله اطمینان 95% ارزیابی گردیدند.

یافته‌ها: میانگین میزان باند در مینا در گروه یک $35/76 \pm 6/19$ مگاپاسکال، در گروه دو $33/62 \pm 5/09$ مگاپاسکال و در گروه سه $34/65 \pm 5/65$ مگاپاسکال به دست آمد که اختلاف بین آنها از لحاظ آماری معنی‌دار نبود. میانگین باند در عاج در گروه یک $35/99 \pm 6/13$ ، در گروه دو $40/20 \pm 10/36$ و در گروه سه $47/60 \pm 6/00$ مگاپاسکال بود. میزان باند در گروه دو از گروه‌های یک و سه بیشتر بود ($P < 0.05$) و اختلاف بین گروه‌های یک و سه از لحاظ آماری معنی‌دار نبود.

نتیجه‌گیری: در 24 ساعت باند دو ماده چسبنده جدید Clearfil SE Bond و Clearfil Tri-S Bond به مینا مشابه Bond و به عاج کمتر از آن بدست آمد.

کلید واژگان: مقاومت باند ریزپرسی (Micro-shear)، سلف اچ، عامل باندینگ

تاریخ اصلاح نهایی: ۱۳۸۴/۳/۲۱

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۳/۹/۸

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۴/۳/۸

مقدمه

لازمه موفقیت در ترمیم‌های همزنگ دندان داشتن مواد چسبنده مؤثر و با کاربری ساده در دندانپزشکی انجام گرفته است. در سیستم‌های سه مرحله‌ای، اچینگ، پرایمینگ و باندینگ مناسب می‌باشد. کوشش‌های زیادی برای ایجاد مواد

*نویسنده مسئول: استادیار گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. E-mail:zahrajaberiansari@yahoo.com

**استادیار گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

***دستیار گروه کریولوژی و ترمیمی، دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی توکیو، ژاپن.

****گروه پروتوز، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

*****استاد گروه کریولوژی و ترمیمی، دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی توکیو، ژاپن.

*****استادیار گروه کریولوژی و ترمیمی، دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی توکیو، ژاپن.

گردید. در این بررسی استحکام ریزپرشی یک نوع باند سلف اج یک مرحله‌ای جدید (آزمایشی) Clearfil Tri-s و یک نوع باند سلف اج دومرحله‌ای جدید Clearfil Protect Bond، ساخت شرکت کاری ژاپن اندازه‌گیری گردیده و با باند سلف اج دومرحله‌ای موفق قبلی این شرکت، Clearfil SE Bond مقایسه گردید.

اجزای تشکیل دهنده مواد مصرف شده به شرح زیر می‌باشند:

Clearfil Protect Bond

Primer: MDP, MDPB, HEMA, Water, Hydrophilic dimethacrylate.

Bond (fluoride – bonding agent): MDP, Bis-GMA, HEMA, Hydrophobic dimethacrylate, di-Camphorquinone, N, N-diethanol - P - toluidine, silanated colloidal silica, surface treated sodium fluoride.

Clearfil SE Bond

Primer: MDP, HEMA, hydrophilic dimethacrylate di-Camphorquinone N, N-diethanol - P - toluidine, water

Bond: MDP, Bis-GMA, HEMA, hydrophobic dimethacrylate, di- Camphorquinone, N, N-diethanol-P- toluidine, silanated colloidal silica

Clearfil Tri – S Bond

MDP, Bis-GMA, HEMA, hydrophobic dimethacrylate, di - Camphorquinone, Ethyl alcohol, Water, Silanated colloidal silica.

پژوهش بر روی دندان‌های عقل نهفته انسان انجام شد. در طول یک ماه دندان‌ها پس از جراحی در نرمال سالین نگهداری شدند. ۲۴ ساعت قبل از تحقیق دندان‌ها شسته شده و برای ضدغونی شدن در محلول تیمول ۰/۰۵ درصد قرار داده شدند. هر دندان در جهت باکولینگوالی و به موازات محور طولی آن توسط دستگاه Isomet (Buehler Ltd, Lake-Bluff, IL, USA)

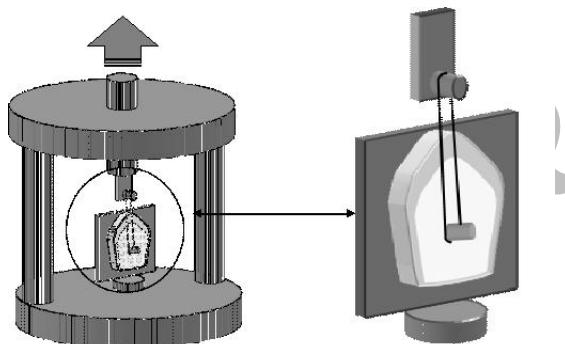
باندینگ علاوه بر وقت‌گیر بودن نسبت به تکنیک بسیار حساس بوده و کوچکترین اخلال در هر مرحله به کاهش باند منجر می‌گردد. به این دلیل سیستم‌هایی معرفی گردیدند که مراحل را در هم ادغام نمایند. از جمله سیستم‌هایی که در آنها پرایمر و رزین چسبنده به طور مخلوط در یک محلول قرار داده شده و پس از اج کردن هم زمان مینا و عاج، روی هر دو محل استفاده می‌گردد(۱). در این سیستم چگونگی اج کردن و نحوه شستشو و خشک کردن حفره حائز اهمیت بسیار می‌باشد(۲).

خشک کردن زیاد عاج سبب فرو افتادن شبکه کلاژنی و کاهش نفوذ پرایمر رزین به آن و در نهایت کاهش باند می‌گردد(۳). به منظور غلبه بر این مشکل سیستم‌های سلف اج معرفی گردیدند. پرایمراهای اسیدی این مواد حاوی مولکول‌هایی هستند که هم‌زمان مینا و عاج را اج کرده و بدون نیاز به شستشو، پرایمر به درون تخلخل‌ها نفوذ می‌کند(۱). به این طریق این مواد از اج شدن و خشک شدن بیش از حد عاج جلوگیری کرده و زمان درمان را نیز کاهش می‌دهند(۴). در این مواد متعاقب مرحله اول، از باندینگ رزین استفاده می‌گردد. به دنبال معرفی مواد سلف اج دومرحله‌ای، به منظور ساده‌تر کردن عمل باندینگ، سیستم‌های سلف اج یک مرحله‌ای (One-step) معرفی شدند که در آنها هر سه جزء ماده اج کننده، پرایمر و باندینگ رزین در یک مرحله روی سطح دندان استفاده می‌شوند(۵). هدف از این پژوهش بررسی مقاومت ریزپرشی دو ماده چسبنده جدید (شامل یک سلف اج یک مرحله‌ای و یک سلف اج دومرحله‌ای) به مینا و عاج می‌باشد.

مواد و روش‌ها

این مطالعه تجربی و روش جمع‌آوری اطلاعات از طریق مشاهده بود. پژوهش در تاریخ ۱۱-۰۴-۱۳۸۴ (۳۰ Apr – 1 May 2005) در بخش کریولوژی و ترمیمی دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی توکیو در کشور ژاپن انجام

نمونه‌ها توسط استریومیکروسکوپ نوری با بزرگنمایی ۳۰ برابر (Olympus, Tokyo – Japan) برای کشف نتایج باندینگ بررسی شدند. نمونه‌های دارای نقص (حباب یا گپ در محل باند و کامپوزیت) از مطالعه خارج شده و نمونه‌های سالم تا رسیدن به تعداد نمونه کافی (۱۰ عدد در هر گروه) جایگزین گردیدند. باند برشی توسط دستگاه (500 N, EZ – test wire and loop Shimadzu Co. Kyoto, Japan) (شکل ۱) اندازه‌گیری شد. سرعت دستگاه ۱ میلی‌متر در دقیقه و قطر سیم استیل دوصد میلی‌متر بود. میزان نیرو در نقطه شکست بر حسب K_{gf} یادداشت شد که بعداً به مگاپاسکال تبدیل گردید. یافته‌ها توسط آزمون ANOVA یک‌طرفه و مقایسه چندتایی LSD با فاصله اطمینان ۹۵٪ مورد بررسی آماری قرار گرفتند.



شکل ۱ - نمای شماتیک Micro – Shear Bond Test

یافته‌ها

استحکام باند ریزبرشی نمونه‌ها پس از ۲۴ ساعت اندازه‌گیری شد. در گروه اول میانگین استحکام باند در میانا 89 ± 6 مگاپاسکال و در عاج 100 ± 6 مگاپاسکال به دست آمد. این مقادیر برای گروه دوم به ترتیب 59 ± 5 و 62 ± 5 مگاپاسکال و در گروه سوم 65 ± 5 مگاپاسکال بود. اطلاعات به دست آمده در جدول ۱ به تفصیل نشان داده شده‌اند.

در صفحات ۱/۵ میلی‌متری برش داده شد. سطوح برش داده شده توسط کاغذ سمباده سیلیکون کرباید ۶۰۰ گریت زیر جریان آب به مدت ۱ دقیقه پرداخت گردیدند. سپس نمونه‌ها به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شده و مورد درمان‌های زیر قرار گرفتند.

در گروه اول مخلوط اج کننده و پرایمر Clearfil Protect Bond (سلف اج دومرحله‌ای) طبق دستورالعمل کارخانه به مدت ۲۰ ثانیه توسط اسفنج روی تمام سطوح مالش داده شد. پس از استفاده از هوا جهت خشک کردن ملایم سطح دندان، باندینگ آن توسط اسفنج دیگری روی سطح قرار داده شده و با هوا ملایم، پخش و یکنواخت گردید. سپس چند عدد لوله شفاف (Tygon, Norton Performance plastic Co. Cleveland, OH, USA) با قطر داخلی $7/8$ میلی‌متر و به طول ۱ میلی‌متر بر روی مینا و عاج قرار داده شده و ۱۰ ثانیه به آنها نور تابانیده شد. داخل تیوب‌ها با کامپوزیت Clearfil AP-X (Kuraray – Japan) به رنگ A3 پر گردیده و ۴۰ ثانیه نور به آنها تابانیده شد. یک ساعت بعد از اتمام باندینگ و پس از خارج کردن لوله‌های شفاف، نمونه‌ها در آب مقطر قرار داده شدند تا پس از ۲۴ ساعت باند ریزبرشی آنها اندازه‌گیری شود. در گروه دوم کلیه این مراحل با استفاده از باند Clearfil SE طبق دستورالعمل کارخانه انجام شد. این ماده سلف اج دومرحله‌ای به عنوان گروه کنترل جهت مقایسه میزان باند دو ماده جدید با آن در نظر گرفته شد.

در گروه سوم از Clearfil Tri – S Bond، باند سلف اج یک مرحله‌ای طبق دستورالعمل کارخانه استفاده گردید. ابتدا باندینگ توسط اسفنج روی سطح دندان قرار داده شده و پس از ۲۰ ثانیه توسط جریان هوا کاملاً پخش و یکنواخت شد (تا آب و حللهای موجود تبخیر شوند). کلیه مراحل بعدی مانند دو گروه دیگر بود.

بعد از ۲۴ ساعت باند ریزبرشی گروه‌ها اندازه‌گیری شد. در ابتدا

جدول ۱ - میانگین، انحراف معیار، حداقل و حدکثر باند برشی سه ماده چسبنده در مینا و عاج

محل	باند	تعداد	میانگین	انحراف معیار	حداقل	حدکثر
مینا	Protect Bond	۱۰	۳۵/۷۶	۶/۸۹	۲۵/۵۳	۴۹/۹۳
	SE Bond	۱۰	۳۳/۶۲	۵/۵۹	۲۷/۱۳	۴۵/۶۰
	Tri-S	۱۰	۳۴/۶۵	۵/۶۵	۲۵/۳۰	۴۱/۹۵
	جمع	۳۰	۳۴/۶۷	۵/۹۳	۲۵/۳۰	۴۹/۹۳
عاج	Protect Bond	۱۰	۳۴/۴۷	۶/۰۰	۲۷/۱۳	۴۴/۶۸
	SE Bond	۱۰	۴۵/۲۰	۱۰/۳۶	۲۷/۸۱	۶۱/۳۳
	Tri-S	۱۰	۳۵/۹۹	۶/۱۳	۲۳/۲۵	۴۴/۶۸
	جمع	۳۰	۳۸/۵۶	۸/۹۱	۲۳/۲۵	۶۱/۳۳

بحث

تقاضای روزافزون ترمیم‌های زیبایی و مواد همنگ دندان سبب شده که تحقیقات بسیاری برای دستیابی به مواد باندینگ مناسب انجام شوند. مواد بسیاری تولید شده‌اند که هر کدام استحکام باند اولیه بالایی را نشان می‌دهند. عامل امتیازدهنده راحتی کاربری، سادگی مراحل و دوام باند آنها می‌باشد. با ابداع مواد توتال اچ، بسیاری از مراحل حساس اچ و باند به مینا و عاج به طور جداگانه، حذف شده، مراحل ساده‌تر گشتند، ولی هنوز مواردی چون اچینگ نامناسب (کم یا زیاد)، شستشو و خشک کردن نامناسب (کم یا زیاد) و تأثیر آنها بر روی باند وجود داشت.

با ساخت مواد سلف اچ دومرحله‌ای سعی برای حذف این مشکلات شد. از مزایای دیگر مواد سلف اچ حساسیت کمتر دندانها بعد از ترمیم می‌باشد که به علت عدم پاک‌سازی کامل توبول‌های عاجی و در نتیجه حرکت کمتر مایع عاجی می‌باشد. این نتیجه حاصل اسیدیته ضعیفتر این مواد نسبت به باندهای کلاسیک دومرحله‌ای است که از اسید فسفوکلرید یا دیگر اسیدهای قوی برای اچ کردن سطح عاج بهره می‌برند. به علاوه نفوذ همزمان باند و اسید امکان باقی ماندن عاج دمینرالیزه و حمایت نشده توسط رزین را به حداقل می‌رساند(۷). همچنین با وجود این اچ ملایم انتظار می‌رود

بررسی آماری توسط ANOVA یک طرفه نشان داد که اختلاف بین میزان استحکام ریزبرشی در مینا در سه گروه معنی‌دار نمی‌باشد. در عاج استحکام ریزبرشی از دو ماده دیگر بیشتر بود ($P < 0.05$) و اختلاف بین Clearfil SE Bond از Clearfil Protect Bond و Clearfil Tri-S از نظر آماری معنی‌دار نبود (جدول ۲).

الگوی شکست نمونه‌ها توسط استریومیکروسکوپ بررسی گردید که نتایج آن در جدول ۳ نشان داده شده است.

جدول ۲- نتیجه آماری استحکام برشی سه ماده چسبنده به عاج

Siq	میانگین تفاوت‌ها (I-J)	باند (I)	باند (J)
۰/۰۰۵	-۱۰/۷۳*	SE Bond	Protect Bond
۰/۶۶۵	-۱/۵۲	Tri-S	
۰/۰۰۵	۱۰/۷۳*	Protect Bond	SE Bond
۰/۰۱۳	۹/۲۱*	Tri-S	
۰/۰۶۵	۱/۵۲	Protect Bond	
۰/۰۱۳	-۹/۲۱*	SE Bond	Tri-S

* تفاوت آماری معنی‌دار می‌باشد.

جدول ۳- الگوی شکست سه ماده چسبنده، در مینا و عاج

Protect Bond	SE Bond	Tri-S Bond	ماده چسبنده
AMC	AMC	AMC	الگوی شکست
۳۴۳	۴۳۳	۷۲۱	مینا
۱۰۰۰	۷۱۲	۹۱۰	عاج

A= Adhesive, C=Cohesive, M=Mixed

Clearfil Tri – S Protect Bond در روی مینا مشابه باند Clearfil SE Bond و در روی عاج از آن کمتر می‌باشد. روشی که در چند سال اخیر برای بررسی استحکام باند برشی و Micro – tensile Micro – shear و کششی استفاده می‌شود در این روش از یک دندان چند برش تهیه شده، روی هر برش می‌توان چند نمونه قرار داد. از مزایای این روش کاهش متغیرهای مداخله‌گر مربوط به نوع، جنس و سن دندان، استفاده از مواد کمتر و نیاز به تعداد دندان بسیار کمتر می‌باشد. اگر چه کار کردن با نمونه‌های بسیار کوچک نیازمند دقت بیشتری می‌باشد. از مزایای دیگر این آزمون‌ها، دقت بسیار بالا و قابلیت آن با توجه به کوچک بودن سطح آزمایش (در حد چند میلیمتر مربع) می‌باشد. زیرا هر چه سطح تحت آزمایش کوچک‌تر باشد احتمال خطأ و نقایص گوناگون کمتر می‌شود^(۸). در بررسی اخیر از این روش استفاده شد.

در یک پژوهش استحکام برشی دو ماده Single bond Clearfil SE bond (Kuraray – Japan) و (3M USA) روی مینای دندان مولر انسان بررسی گردید^(۹). در این مطالعه استحکام باند به طریق Micro – shear در گروههای ۱۰ عددی، پس از یک روز، یک هفته، یک ماه، سه ماه، شش ماه و یک سال اندازه‌گیری شد و نحوه شکست نمونه‌ها توسط میکروسکوپ الکترونی بررسی گردید. میزان استحکام برشی پس از ۲۴ ساعت در Clearfil SE Bond برابر $37/9 \pm 8/22$ در Single bond برابر $35/0 \pm 6/68$ مگاپاسکال بود. نحوه شکست در Clearfil SE Bond، پنج مورد ادھری و پنج مورد مخلوط و در Single Bond نه مورد ادھری و یک مورد مخلوط بوده، هیچ کدام شکست کوهزیو صد درصد نداشتند. در پژوهش دیگری، استحکام باند کامپوزیت به مینا و عاج و DEJ دندان مولر انسان به طریق Micro – shear بررسی گردید^(۱۰). در این مطالعه از Clearfil SE Bond، Clearfil SE Bond و One – step Bond استفاده شد (۱۰ نمونه در هر

میزان یون‌های معدنی شرکت کننده در لایه هیبرید باندینگ افزایش باید که خود به افزایش قدرت باند خواهد انجامید. لازم به ذکر است که منومر MDP (10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate) در هر سه ماده مورد آزمایش وجود دارد به علت خاصیت قطبیتی که دارد احتمالاً با یون‌های معدنی هم چون کلسیم واکنش می‌دهد که این مسئله به افزایش قدرت باند کمک خواهد کرد^(۷).

تحقیقات بعدی برای ساده‌تر کردن بیشتر مراحل بر روی مواد سلف اج یک مرحله‌ای متمنکر گردیدند. در این مواد، ماده اج کننده، پرایمر و باندینگ هم زمان روی سطح دندان استفاده شده و پس از آن بلافارسله کامپوزیت گذاشته می‌شود. انتظار می‌رود با حذف یک مرحله و حساسیت‌های ناشی از آن بتوان به باند مؤثرتری دست یافت، ضمن آنکه کاهش زمان کار هم نتیجه مثبت دیگر آن خواهد بود. Tri – S یک باند سلف اج یک مرحله‌ای جدید است که توسط شرکت کوراری معرفی گردیده است.

تحقیقات دیگری که در زمینه بهبود باندها انجام گرفته‌اند افزودن موادی به آنها، برای مقاوم کردن دندان در برابر پوسیدگی را پیشنهاد می‌نماید. Protect Bond یک باند سلف اج دومرحله‌ای جدید شرکت کوراری می‌باشد که به ترکیب باندینگ آن فلوراید افزوده شده است. باندهای جدید نیازمند آزمایش‌های همه جانبه‌ای می‌باشند تا بتوانند به عنوان یک باند مؤثر مورد قبول واقع شوند. یک بعد این آزمایش‌ها بررسی استحکام برشی باند، بخصوص در طولانی مدت می‌باشد که در این پژوهشی مورد ارزیابی قرار گرفته و مقاله حاضر نتایج ۲۴ ساعته آن را بیان می‌کند. در این مطالعه استحکام باند – Micro این دو نوع باند آزمایشی جدید به مینا و عاج بررسی و نتایج با Clearfil SE Bond سنجیده شد.

یافته‌ها نشان دادند که میزان باند ریزبرشی اولیه Clearfil

نمود که ترکیب منومرهای موجود در Clearfil Protect Bond برای ایجاد خاصیت ضدمیکروبی تغییراتی یافته‌اند که اثر این تغییرات و دیگر تغییرات در فرمولاسیون ممکن است تأثیر نامطلوبی بر باندینگ کوتاه‌مدت ماده داشته باشد. هرچند لازم است اثرات بلندمدت این تغییرات، به خصوص در رابطه با خواص مثبت ضدمیکروبی و آزادسازی فلوراید بررسی شود. نحوه شکست در مینا سه مورد ادھریو چهار مخلوط و سه مورد کوهزیو و در عاج تمام ده نمونه ادھریو بود.

در مورد S – Clearfil Tri، میانگین باند در مینا $34/65$ مگاپاسکال و حداکثر باند $41/95$ مگاپاسکال بود. در این مورد هم اگر چه باند از Clearfil SE Bond بیشتر است ولی اختلاف آن از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد و می‌توان گفت باند آن مشابه Clearfil SE Bond می‌باشد. اما در مورد عاج میزان باند به طور معنی‌داری از Clearfil SE Bond کمتر است. دلیل این امر را می‌توان چنین بیان داشت که تک مرحله‌ای بودن این مواد به این معنی است که آب و حلال‌های باند هم چون الكل یا استون در محلول باندینگ وجود دارند. انتظار می‌رود بعد از کاربرد باند و قبل از سخت کردن توسط نور، این آب و حلال‌ها توسط جربان‌های پوآر تبخیر شوند. چنان‌چه به دلیلی این مواد کاملاً از باندینگ خارج نشوند می‌توانند با اثر منفی روی روند پلیمریزاسیون باعث کاهش قدرت باند شوند(۱۲) که نتایج تحقیق حاضر نیز چنین فرضیه‌ای را ترغیب می‌نماید. نحوه شکست در مینا در هفت مورد ادھریو، در دو مورد مخلوط و در یک مورد ادھریو و در یک مورد مخلوط بوده و شکست کوهزیو نداشته است.

نتیجه‌گیری

استحکام برشی دو ماده جدید بعد از ۲۴ ساعت روی مینا مشابه Clearfil SE Bond و در روی عاج از آن کمتر بود.

گروه) چگونگی شکست نمونه‌ها توسط میکروسکوپ الکترونی لیزری (Confoval laser scanning microscopy) بررسی گردید. نتایج نشان داد که میانگین استحکام برشی Single DEJ در مینا $38/0 \pm 8/81$ ، در عاج $44/3 \pm 3/74$ و در One – step Bond $37/0 \pm 5/98$ مگاپاسکال بود. نتایج برای به ترتیب $1/11$ ، $38/8 \pm 6/49$ ، $43/3 \pm 11/1$ و برای $39/5 \pm 7/0$ ، $38/0 \pm 6/35$ Clearfil SE Bond مگاپاسکال بود. نحوه شکست Clearfil SE Bond در مینا هفت ادھریو، یک مخلوط و دو کوهزیو و در عاج دو ادھریو، چهار مخلوط و چهار کوهزیو بود.

در پژوهش دیگری میزان باند برشی Clearfil SE Bond روی عاج دندان دائمی (مولر سوم) برابر $39/81 \pm 6/8$ مگاپاسکال و روی دندان شیری $37/38 \pm 6/28$ مگاپاسکال به دست آمد (۱۱).

در بررسی اخیر استحکام باند برشی Clearfil SE Bond بر روی مینا $33/62 \pm 5/5$ مگاپاسکال و روی عاج $45/20 \pm 3/6$ مگاپاسکال، و الگوی شکست آن در مینا چهار ادھریو، سه مخلوط و سه کوهزیو و در عاج هفت ادھریو، یک مخلوط و دو کوهزیو بود.

در این پژوهش میزان باند Clearfil SE Bond در مینا ($33/62$ مگاپاسکال) از دو بررسی خارجی ($9/10$) کمتر و میزان باند آن در عاج ($45/20$ مگاپاسکال) از پژوهش‌های خارجی ($10/11$) بیشتر به دست آمد.

میانگین باند برشی Clearfil Protect Bond در مینا $35/76$ مگاپاسکال و حداکثر باند به دست آمده $49/93$ مگاپاسکال بود. اگر چه میزان این میانگین از میانگین Clearfil SE Bond بیشتر به نظر می‌رسید اما اختلاف بین آنها معنی‌دار نبود و در عاج میانگین باند $34/47$ و حداکثر باند $44/68$ مگاپاسکال بود که اختلاف آن با Clearfil SE Bond معنی‌دار بوده، از آن کمتر می‌باشد. علت این کاهش را می‌توان به این طریق بیان

راهگشایی ایشان انجام این پژوهش مقدور نبود صمیمانه تشکر

تقدیر و تشکر

و قدردانی می‌گردد.

بدین وسیله از جناب آقای دکتر امیر قاسمی که بدون

References

1. Roberson TM, Heyman H, Swift EJ: Art and science of operative dentistry. 4th Ed. St. Louis: The C.V Mosby Co. 2002;Chap5:237-61.
2. Gwinnett AY: Moist versus dry dentin: its effect on shear bond strength. Am J Dent 1992;5:127-9.
3. Kanca J: Resin bonding to wet substrate. I. Bonding to dentin. Quintessence Int 1992;23:39-41.
4. Nishida K, Yamauchi J, Wada T: Development of a new bonding system. J Dent Res 1993;72:137(Abs).
5. Rosa BT, Perdigao J: Bond strength of non – rinsing adhesives. Quintessence Int 2000;31:353-8.
6. Pontes DG, Melo AT, Monnerat AF: Microleakage of new all – in – one adhesive systems on dentinal and enamel margins. Quintessence Int 2002;33:136-9.
7. De Munck J, Van Landuyt K, Peumans M, Poitevin A, Lambrechts P, Braem M, Van Meerbeek B: A critical review of the durability of adhesion to tooth tissue: methods and results. J Dent Res 2005;84:118-32.
8. Shimada Y, Yamaguchi S, Tagami J: Micro – shear bond strength of dual – cured resin cement to glass ceramics. Dent Mater 2002;18:380-8.
9. Wang H, Shimada Y, Tagami J: Shear bond stability of current adhesive system to enamel. Oper Dent 2004;29:168-175.
10. Shimada Y, Iwamoto N, Kawashima M, Burrow MF, Tagami J: Shear bond strength of current adhesive systems to enamel, dentin and dentin – enamel junction region. Oper Dent 2003;28:585-90.
11. Senawongse P, Harnirattisai C, Shimada Y, Tagami J: Effective bond strength of current adhesive systems on deciduous and permanent dentin. Oper Dent 2004;29:196-202.
12. Sadr A, Shimada Y, Tagami J: Bond strengths of two adhesives and effects of application methods. J Dent Res 84 (Spec Iss A): IADR 2005:150.